RoHS 声明

上海芯龙半导体技术股份有限公司提供的产品符合欧盟指令 2011/65/EU（2011 年 7 月 21 日输入）和修订的指令（EU）2015/863（2019 年 7 月 22 日生效）限制使用有害物质(“RoHS”)。

XLSEMI products to comply with EU Directive 2011/65/EU (entered July 21, 2011) and the amended Directive (EU) 2015/863 (effective July 22, 2019) for Restriction of the Use of Hazardous Substances (“RoHS”).

上海芯龙半导体技术股份有限公司对“符合 RoHS 标准”产品的定义包括：

XLSEMI defines “RoHS Compliant” products as follows:

1、 不含超过表一所示最大阈值的限制物质；

Do not contain restricted substances above the maximum threshold values shown in Table 1

2、 在适用情况下，可适用于表二所示的 RoHS 附件 III 中铅(Pb)的豁免条款之一。

Where applicable, may be subject to one of the RoHS Annex III exemptions for lead (Pb) as shown in Table 2.

表一:

Table 1:

物质 Substances name	阈值 Threshold	欧盟 RoHS 指令 EU RoHS Directive
Cadmium (Cd) 镉以及镉化合物	0.01% (100ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Lead (Pb) 铅以及铅化合物	0.1% (1000ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Mercury (Hg) 汞以及汞化合物	0.1% (1000ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Hexavalent Chromium (Cr6+)六价铬化合物	0.1% (1000ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Polybrominated biphenyls (PBBs) 聚溴联苯	0.1% (1000ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Polybrominated diphenylethers (PBDEs) 聚溴二苯醚	0.1% (1000ppm)	2002/95/EC amended 2011/65/EU
Bis(2–ethylhexyl) phthalate (DEHP)邻苯二甲酸(2–乙基己基酯)	0.1% (1000ppm)	EU 2015/863, enforced 22 Jul 2019
Butyl benzyl phthalate (BBP) 邻苯二甲酸丁苄酯	0.1% (1000ppm)	EU 2015/863, enforced 22 Jul 2019
Dibutyl phthalate (DBP) 邻苯二甲酸二丁酯	0.1% (1000ppm)	EU 2015/863, enforced 22 Jul 2019
Diisobutyl phthalate (DIBP) 邻苯二甲酸二异丁酯	0.1% (1000ppm)	EU 2015/863, enforced 22 Jul 2019

表二:

Table 2:

欧盟豁免 EU RoHS Exemption	条款 Description	欧盟 RoHS 指令 EU RoHS Directive
7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead based alloys containing 85 % by weight or more lead) 高熔点型焊料中的铅(即含铅 85%或以上的铅基合金)	2002/95/EC amended 2011/65/EU

上海芯龙半导体技术股份有限公司
质量部
2023/4/4